

Produktänderungsmitteilung *Product Change Notification*

Titel Title Änderung der Bauhöhe MiniDIL *MiniDIL Device Height Conversion*

Typen Types S40, S80, S125, S250, S380, S500; S40F, S80F, S125F, S250F, S380F

Grund der Änderung Die neue „schlanke“ Bauhöhe bringt den Anwendern Vorteile beim Leiterplattenentwurf und Bestücken. Die Bauteile können auf der Leiterplattenunterseite angeordnet werden, wo normalerweise die Bauhöhe beschränkt ist.

Reason of Change *The new "slim" height will bring assembly and printed circuit board (PCB) routing advantages to the customer. Devices can be assembled on the bottom side of the PCB, where space is normally restricted.*

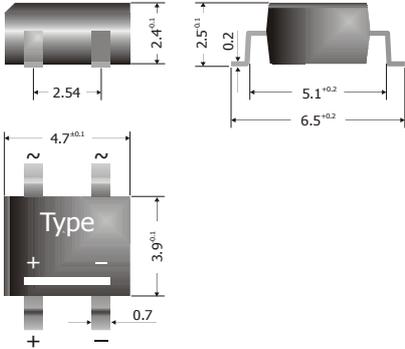
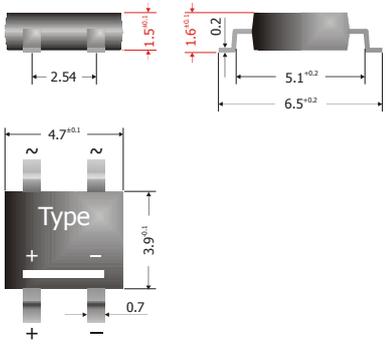
Zustimmung Diese Mitteilung wird an alle Diotec Kunden verteilt und auf unserer Internetseite veröffentlicht. Diotec betrachtet diese Änderung als akzeptiert, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Ausgabedatum in schriftlicher Form eine gesonderte Vorgehensweise gefordert wird. Hierzu ist der jeweilige Diotec Semiconductor Vertriebskanal zu kontaktieren.

Acceptance *This notice is distributed to all Diotec customers and published on our website. Diotec will consider this change approved unless specific conditions of acceptance are provided in writing within 30 days after issuing of this notice. To do so, contact your local Diotec Semiconductor sales channel.*

**Art der Änderung
Type of Change**

Major

Minor

	Bisher Current	Neu New
Mechanisch Mechanical		
Elektrisch Electrical		Keine Änderungen <i>No changes</i>
Verpackung Packaging	3000 Stk. <i>pcs</i> 13" Rolle Blistergurt <i>tape&reel</i>	4000 Stk. <i>pcs</i> 13" Rolle Blistergurt <i>tape&reel</i>
Bestell-Nr. Ordering Code		Keine Änderungen <i>No changes</i>
Artikel-Bezeichnung Part Description	In Auftragsbestätigung und auf den Bauteil-Etiketten (Bsp.) <i>In order confirmation and on device labels (example):</i> "S250"	In Auftragsbestätigung und auf den Bauteil-Etiketten (Bsp.) <i>In order confirmation and on device labels (example):</i> "S250 slim package, 1.6mm high"

Lieferbarkeit Availability	<p>Letzte Auslieferung der bisherigen Version erfolgt Ende 2010</p> <p><i>Last delivery of current version will be done end of 2010</i></p>	<p>Bei Neuaufträgen mit Lieferung ab September 2010 wird die neue Version bestätigt. Laufende Aufträge werden gesondert geprüft und Lieferungen evtl. in alte und neue Version aufgeteilt (in solchen Fällen wird eine geänderte Auftragsbestätigung übermittelt).</p> <p><i>At new orders with delivery from September 2010, the new version will be confirmed. Running orders will be checked separately and deliveries eventually split into new and old version (in such case a change of order confirmation will be provided)</i></p>
---	---	--

Durchgeführte Tests Tests done	<p>Electrical and Mechanical Parameters</p> <p>HTRB, 500h, 125°C, 80% V_{RRM}</p> <p>High Temperature High Humidity, 500h, 85°C, 85% rH</p> <p>Pressure Cooker, 5h, 120°C, 130kP</p> <p>High Temperature Storage, 50h, T_{smax}</p> <p>Low Temperature Storage, 50h, T_{smin}</p> <p>Temperature Cycling, 50 cycles T_{smin} – T_{smax}</p> <p>Resistance to solder heat</p>
---	--